

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成18年3月16日(2006.3.16)

【公開番号】特開2005-262363(P2005-262363A)

【公開日】平成17年9月29日(2005.9.29)

【年通号数】公開・登録公報2005-038

【出願番号】特願2004-77299(P2004-77299)

【国際特許分類】

B 24 B 1/00 (2006.01)

【F I】

B 24 B 1/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成18年1月31日(2006.1.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0038

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0038】

図7に、実施例1により研削した炭化けい素ファインセラミックの工作物の表面の光干渉式高精度表面測定器(WYKO)による二次元粗さ測定によるX、Yプロファイルを示す。図7よりわかるように、実際に得られた研削方向平行仕上面粗さは、P-V値で14nm(図7では、R_t値)、R_a値で3nm以下であり、一方、研削方向直角仕上面粗さは、P-V値で約23nm、R_a値で約4nmとなっており、高能率に超平滑研削加工が行えたことが分かる。